



## 報道発表

2011年9月12日

報道関係者各位

# eBeam Initiative のメンバー会社が SPIE/BACUS Photomask Symposium 2011 で協業の成果を発表

## 新たに5社が eBeam Initiative に参加

(米国 San Jose 発) 電子ビーム技術をベースにした新しい半導体製造手法を普及、促進するためのフォーラム eBeam Initiative は、本日、最先端フォトマスク技術の国際会議・展示会である SPIE/BACUS Photomask Symposium 2011 において、幾つかのメンバー会社がマスク技術および直描技術の最新の成果を報告すると発表しました。このメンバーの共同開発の成果により、電子ビーム技術が 20nm プロセスノード以降の最先端マスクと半導体製造をサポートして行けることが実証されました。SPIE/BACUS Photomask Symposium 2011 は、カリフォルニア州モントレーのマリオット・ホテルで9月19日-22日に開催されます。

さらに、eBeam Initiative は、新たに5社がメンバーに加わったことを発表いたしました。これらの新メンバー—Applied Materials, IMS CHIPS, Mentor Graphics, Multibeam Corporation および SoftJin Technologies—のイニシアティブへの参加によって、新しい電子ビーム技術の商業化をサポートするために不可欠なエコシステム(関連技術・事業環境)がさらに強化されます。

Aki Fujimura (eBeam Initiative の事務局会社 D2S Inc. の CEO)  
「20nm 以降のプロセスノードでは、リソグラフィー技術がどのような方向に行こうとも、電子ビーム技術は、マスクコストの削減とタイム・トゥ・マーケットの短縮のため、益々重要な役割を担います。そのために必要な、Multi eBeam(MEB)や Model-based mask data preparation(MB-MDP)のような新しい電子ビーム技術は既に着々と準備されており、今先端ノードを目指す半導体産業にとって必要なことは電子ビーム技術への継続的な投資とともに、半導体の設計から製造を横断する全関連業界の協力体制であることを訴えたいと思います。半導体メーカーが費用対効果を継続的に向上して行くために協力している、イニシアティブの既存メンバーおよび新たなメンバーのご支援に深く感謝しております。」

SPIE/BACUS Photomask Symposium 2011 で eBeam Initiative メンバーは以下の論文を発表する予定です。

### 9月19日(月)

- 午後3時40分: Photomask Japan Special Session, Session JPM1- “Benefits of overlapping shots for ArF and EUV mask process correction,” presented by D2S

## 9月20日(火)

- 午後4時30分: Session 6, Mask Data Preparation and Process Correction – “QoR analysis of fractured data solutions using distributed processing,” presented by SoftJin Technologies
- 午後4時50分: Session 6, Mask Data Preparation and Process Correction – “Reducing shot count through optimization-base fracture,” presented by Mentor Graphics Corporation
- 午後6時00分: Poster Session – “Optimization of mask shot count using MB-MDP and lithography simulation,” presented by GLOBALFOUNDRIES and D2S

## 9月21日(水)

- 午前11時00分: Session 12, Mask Pattern Generation I – “EBM-8000: EB mask writer for product mask fabrication of 22-nm half-pitch generation and beyond,” presented by NuFlare Technology

## 9月22日(木)

- 午前11時30分: Session 24, New Mask Making and Alternatives II – “Bottlenecks in data preparation flow for multibeam direct write,” presented by Synopsys

SPIE/BACUS Photomask Symposium 2011 での eBeam Initiative のその他の活動内容に関しては、[www.ebeam.org](http://www.ebeam.org) をご参照下さい。

### **eBeam Initiative について**

eBeam Initiative は、電子ビーム技術をベースにした新たな半導体製造手法を普及、促進するためのフォーラムです。このイニシアティブの目標は、IC の設計数を増やし、タイム・トゥ・マーケットを短縮するために、技術の適用障壁を減らすと同時に、関連業界における電子ビーム技術への投資を拡大することです。イニシアティブのメンバーとアドバイザーは半導体関連業界広くにわたっており、米 Abeam Technologies、株式会社アドバンテスト、台湾 Alchip Technologies、独 AMTC、米 Applied Materials、米 Artwork Conversion、米 ケイデンス・デザイン・システムズ、仏 CEA/Leti、米 D2S 社、大日本印刷株式会社、独 EQUIcon Software GmbH Jena 社、株式会社イー・シャトル、米 eSilicon Corporation 社の Jack Harding 氏、米 Fastrack Design 社、独 Fraunhofer CNT、富士通セミコンダクター株式会社、独 GenISys GmbH 社、米 グローバルファンドリーズ社、Grenon Consulting、HOYA 株式会社、IMS CHIPS 社、日本電子株式会社 (JEOL)、米 KLA-Tencor 社、米 マグマ・デザイン・オートメーション社、米 Mentor Graphics 社、米 Multibeam 社、日本コントロールシステム株式会社、株式会社ニューフレアテクノロジー、米 Petersen Advanced Lithography 社、米 PMC-Sierra 社の Colin Harris 氏、米 アルコム社の Riko Radojcic 氏、韓国サムスン・エレクトロニクス社、印 SoftJin 社、仏 STMicroelectronics 社、米 Synopsys 社、米 Tela Innovations 社、Tool 株式会社、凸版印刷株式会社、独 Vistec Electron Beam Lithography Group、Xilinx が含まれます。また、本イニシアティブは、エレクトロニクス業界におけるあらゆる企業および機関に対し、幅広く参加を募っています。URL: [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org).

**MCA**

David Moreno

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: [dmoreno@mcapr.com](mailto:dmoreno@mcapr.com)

本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。